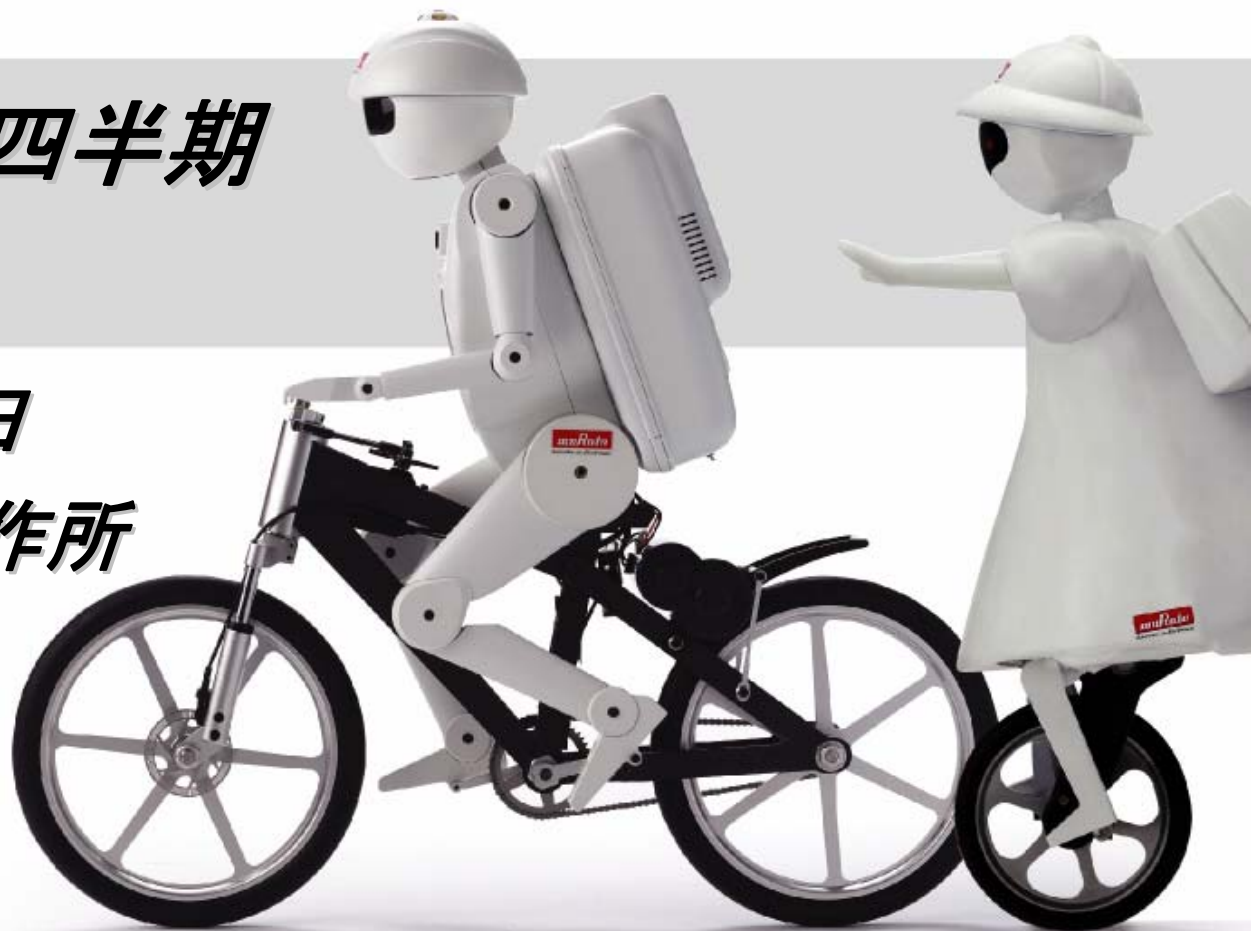


# 2008年度第3四半期 決算説明会

2009年1月30日

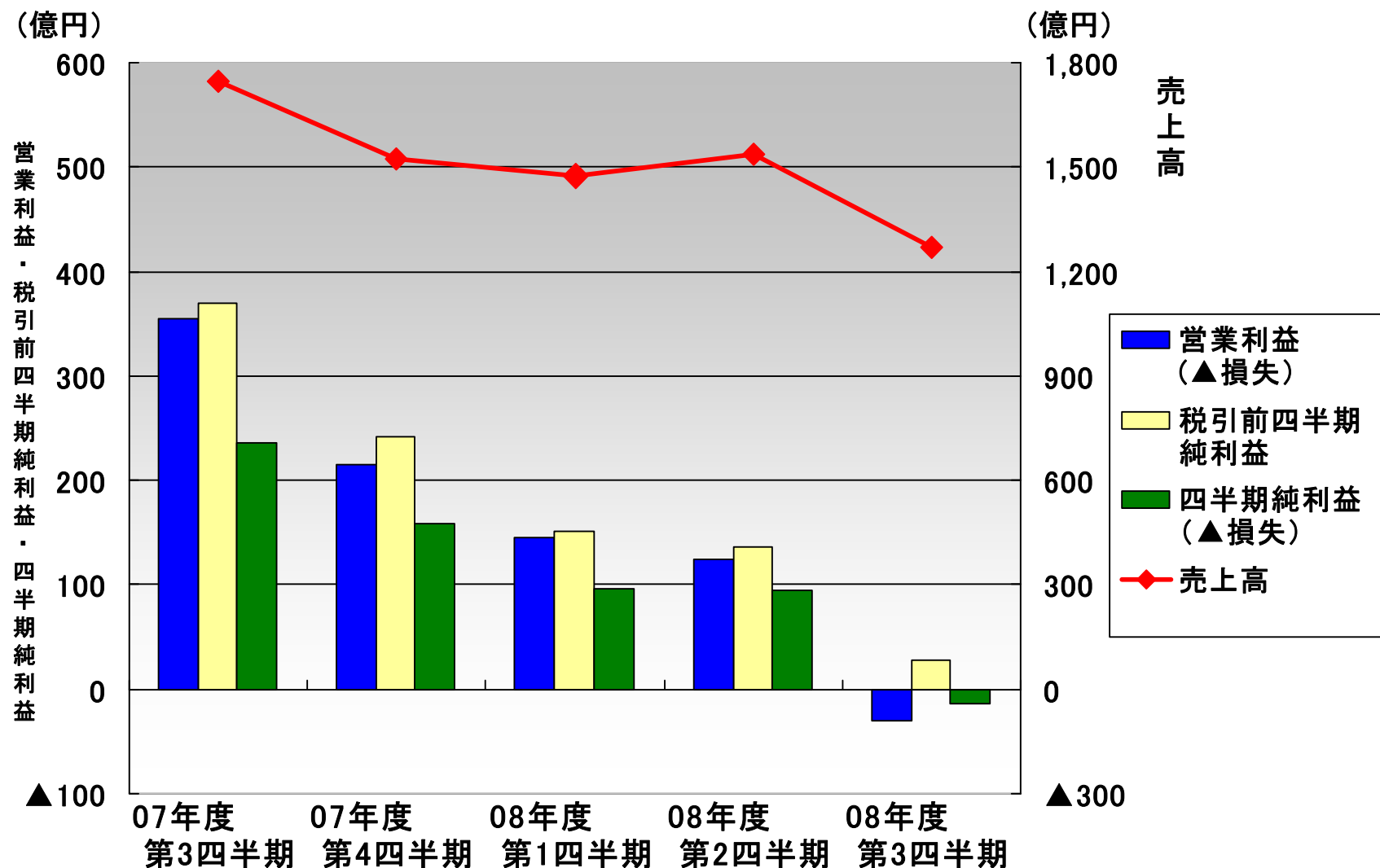
株式会社村田製作所



# **1. 2008年度 第3四半期業績概要**

**2008年10月～2008年12月  
第3四半期連結会計期間**

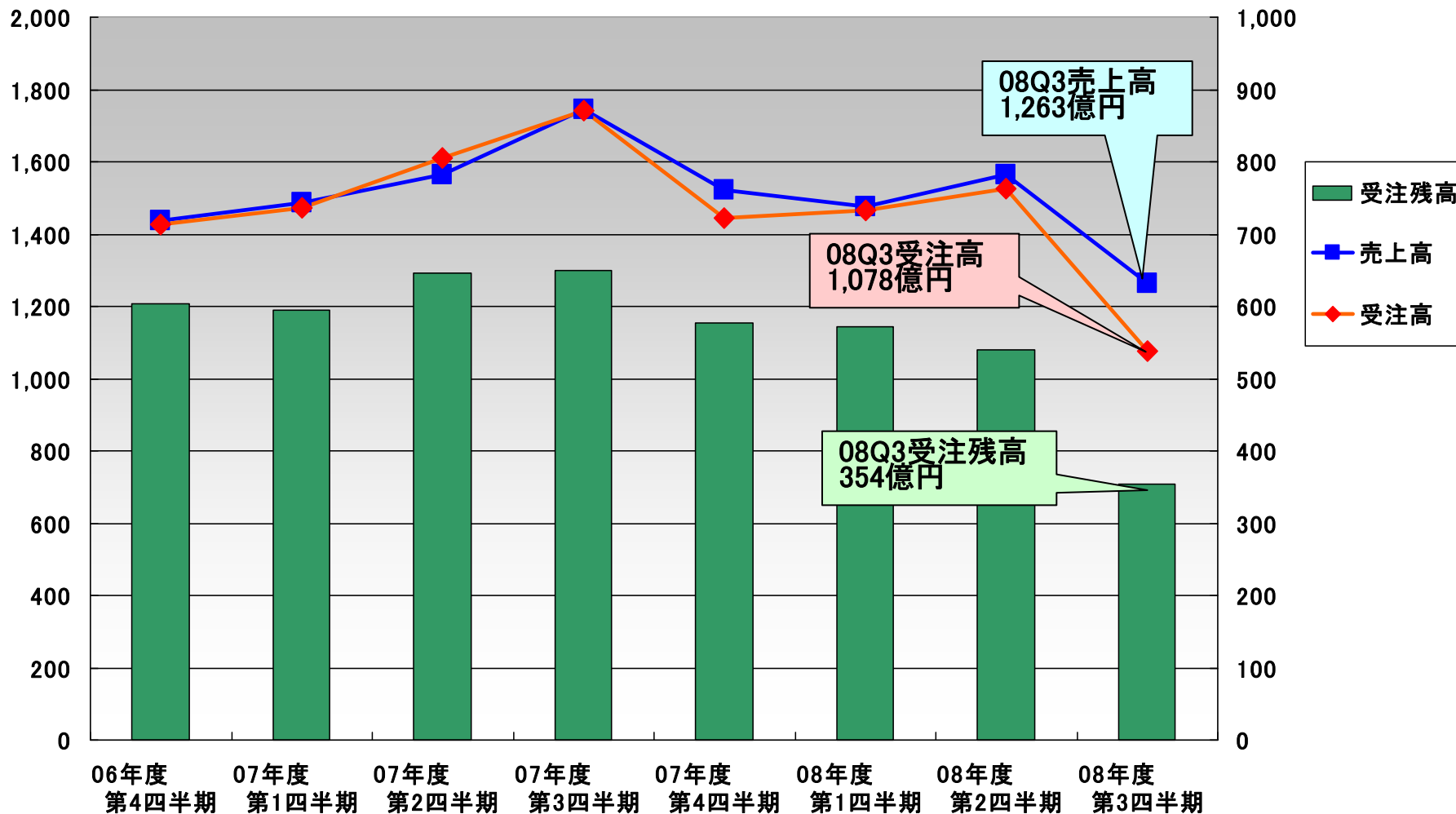
# 業績概要



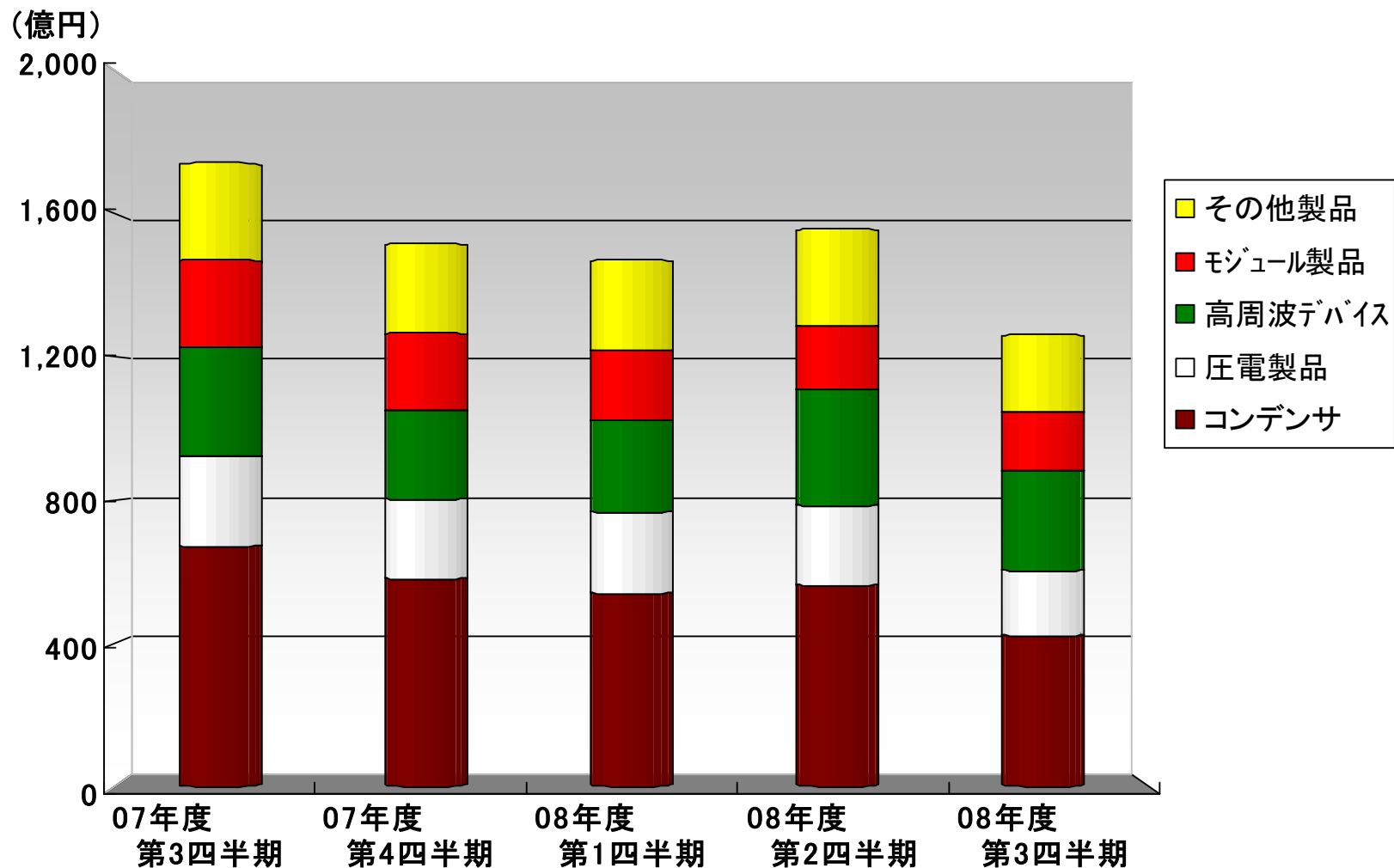
# 四半期の売上・受注・注残推移

売上高・受注高(億円)

受注残高(億円)



# 製品別売上高推移



# 製品別売上高

	2007年度 第3四半期		2008年度 第3四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	672	38.6	421	33.3	▲251	▲37.4
圧電製品	252	14.5	180	14.3	▲71	▲28.4
高周波デバイス	303	17.4	281	22.3	▲22	▲7.2
モジュール製品	243	13.9	162	12.9	▲80	▲33.0
その他製品	270	15.6	218	17.2	▲52	▲19.4
製品売上高計	1,740	100.0	1,263	100.0	▲477	▲27.4

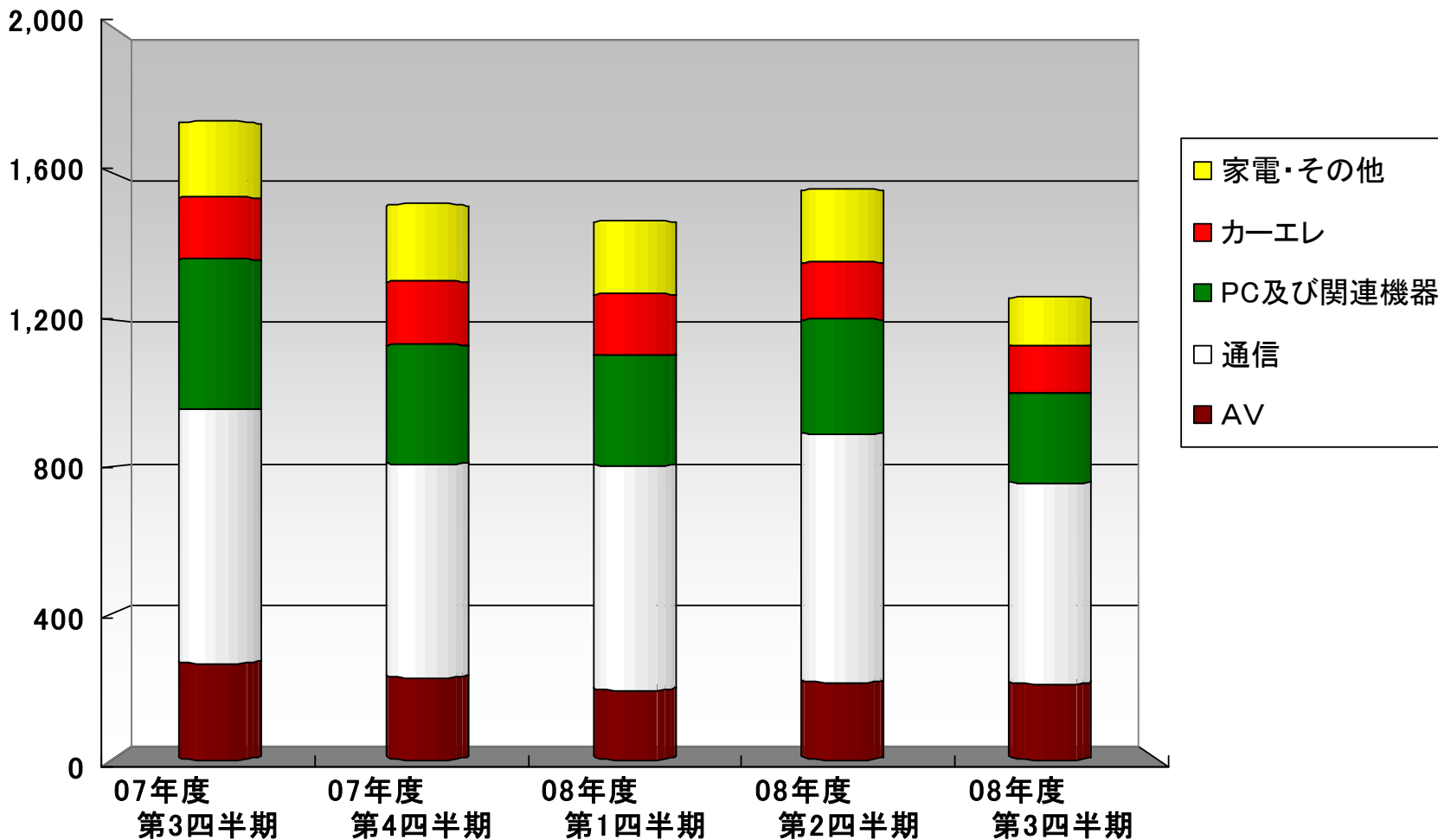
# 製品別売上高

<b>コンデンサ</b> (前年同期比▲37.4%)	<ul style="list-style-type: none"><li>チップ積層セラミックコンデンサ：すべての用途で大幅に減少</li><li>用途特化型品：PC及び関連機器向けで大きく減少</li></ul>
<b>圧電製品</b> (前年同期比▲28.4%)	<ul style="list-style-type: none"><li>表面波フィルタ、セラミック発振子、セラミックフィルタ：通信機器向け、カーエレ向けで大幅に減少</li><li>圧電センサ：PC及び関連機器向けで大きく減少</li><li>圧電ブザー：AV機器向けで大幅に伸長</li></ul>
<b>高周波デバイス</b> (前年同期比▲7.2%)	<ul style="list-style-type: none"><li>近距離無線通信モジュール：無線LANモジュールが大幅に伸長</li><li>多層デバイス：通信機器向けで大幅に減少</li><li>アイソレータ：通信機器向けで大きく減少</li></ul>
<b>モジュール製品</b> (前年同期比▲33.0%)	<ul style="list-style-type: none"><li>電源：AV機器向けで大幅に減少</li><li>回路モジュール：携帯電話用の地上デジタルチューナが大幅に増加、通信機器用モジュールが大きく減少</li></ul>
<b>その他製品</b> (前年同期比▲19.4%)	<ul style="list-style-type: none"><li>EMI除去フィルタ：AV機器向け、PC及び通信機器向け、カーエレ向けで大幅に減少</li><li>チップコイル：通信機器向けで減少</li><li>ジャイロセンサ：AV機器向けで大きく減少</li></ul>

(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です

# 用途別売上高推移

(億円)



# 用途別売上高

	2007年度 第3四半期		2008年度 第3四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
AV	261	15.0	206	16.3	▲54	▲20.9
通信	697	40.1	550	43.5	▲147	▲21.1
PC及び関連機器	407	23.4	246	19.5	▲162	▲39.7
カーエレ	169	9.7	128	10.1	▲42	▲24.7
家電・その他	205	11.8	133	10.6	▲72	▲35.0
製品売上高計	1,740	100.0	1,263	100.0	▲477	▲27.4

# 用途別売上高

<b>AV機器</b> (前年同期比▲20.9%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 薄型テレビ向け、DSC向け、ゲーム機向けが大幅に減少</li><li>• 携帯型オーディオプレーヤー向けで大幅に増加</li></ul>
<b>通信</b> (前年同期比▲21.1%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 第3世代機向けに無線LANモジュールが大幅に増加</li><li>• 通信機器全般にチップ積層セラミックコンデンサ、表面波フィルタが大きく減少</li></ul>
<b>PC及び関連機器</b> (前年同期比▲39.7%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• すべてのセットで大幅に減少</li></ul>
<b>カーエレ</b> (前年同期比▲24.7%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• カーオーディオ向け、ソナー向け、RKE向けが減少</li></ul>

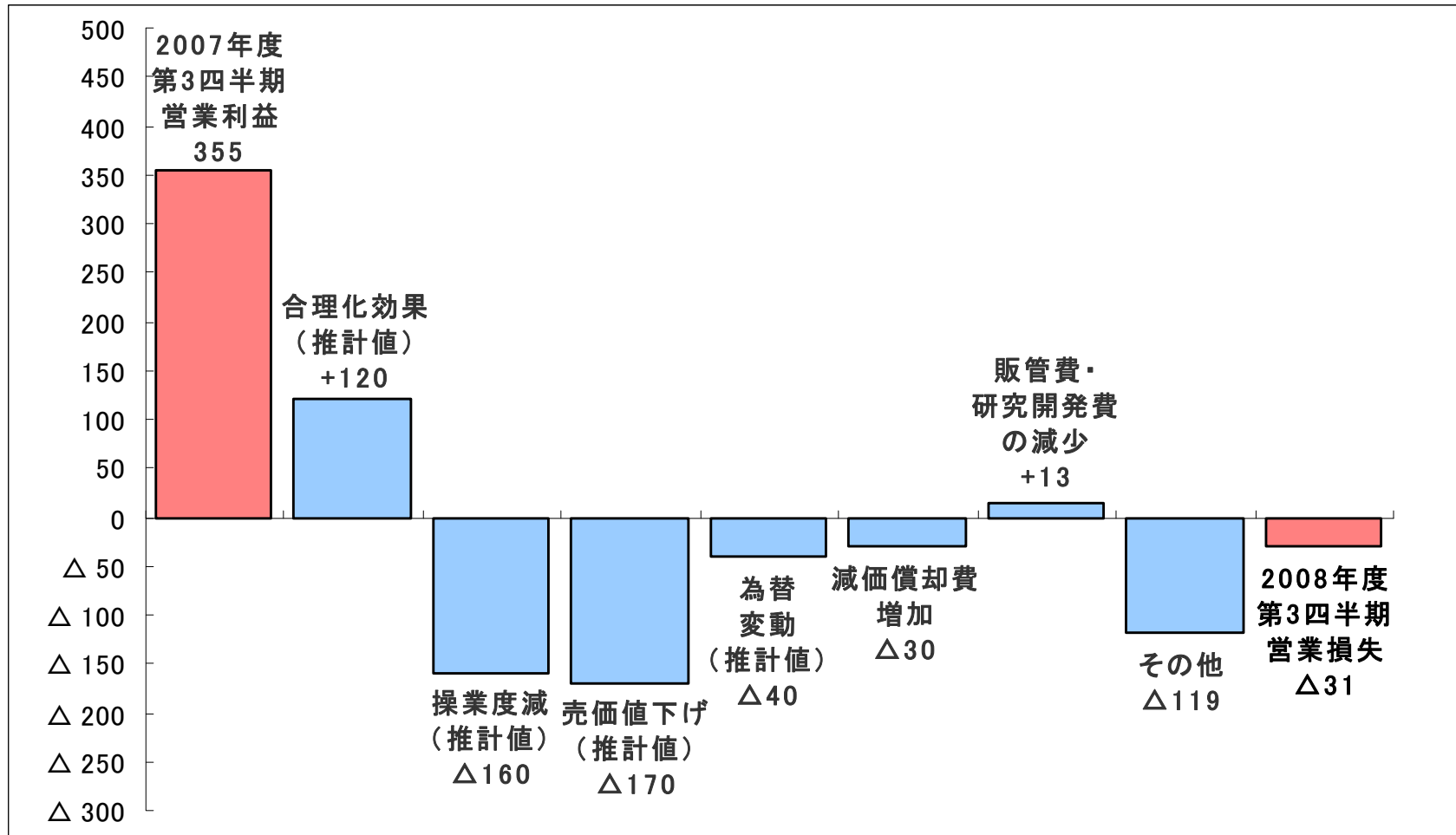
※RKE:リモート・キーレス・エントリー

# 業績概況

	2007年度 第3四半期		2008年度 第3四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	1,746	100.0	1,268	100.0	▲477	▲27.3
営業利益(▲損失)	355	20.3	▲31	▲2.4	▲386	—
税引前利益	370	21.2	28	2.2	▲342	▲92.5
当期純利益(▲損失)	236	13.5	▲13	▲1.0	▲249	—

# 2008年度第3四半期 営業利益変動要因

(億円)



## **2. 2008年度 業績予想**

**(2008年4月～2009年3月)**

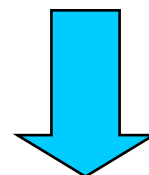
# 部品需要予測

## 携帯電話

11.7億台(2007年度) → 11.2億台(2008年度)

08/10予想	2007年度			2008年度前提			(億台) 通期 伸率
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
部品需要台数	5.6	6.1	11.7	6.1	6.1	12.2	4%

(※当社推定値)



今回予想	2007年度			2008年度前提			(億台) 通期 伸率
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
部品需要台数	5.6	6.1	11.7	6.3	4.9	11.2	-5%

(※当社推定値)

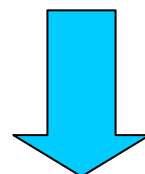
# 部品需要予測

PC

2.8億台(2007年度) → 2.7億台(2008年度)

08/10予想	2007年度			2008年度前提			(億台)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期伸率
部品需要台数	1.4	1.3	2.8	1.4	1.4	2.9	5%

(※当社推定値)



今回予想	2007年度			2008年度前提			(億台)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期伸率
部品需要台数	1.4	1.3	2.8	1.6	1.1	2.7	-4%

(※当社推定値)

# 2008年度の業績予想

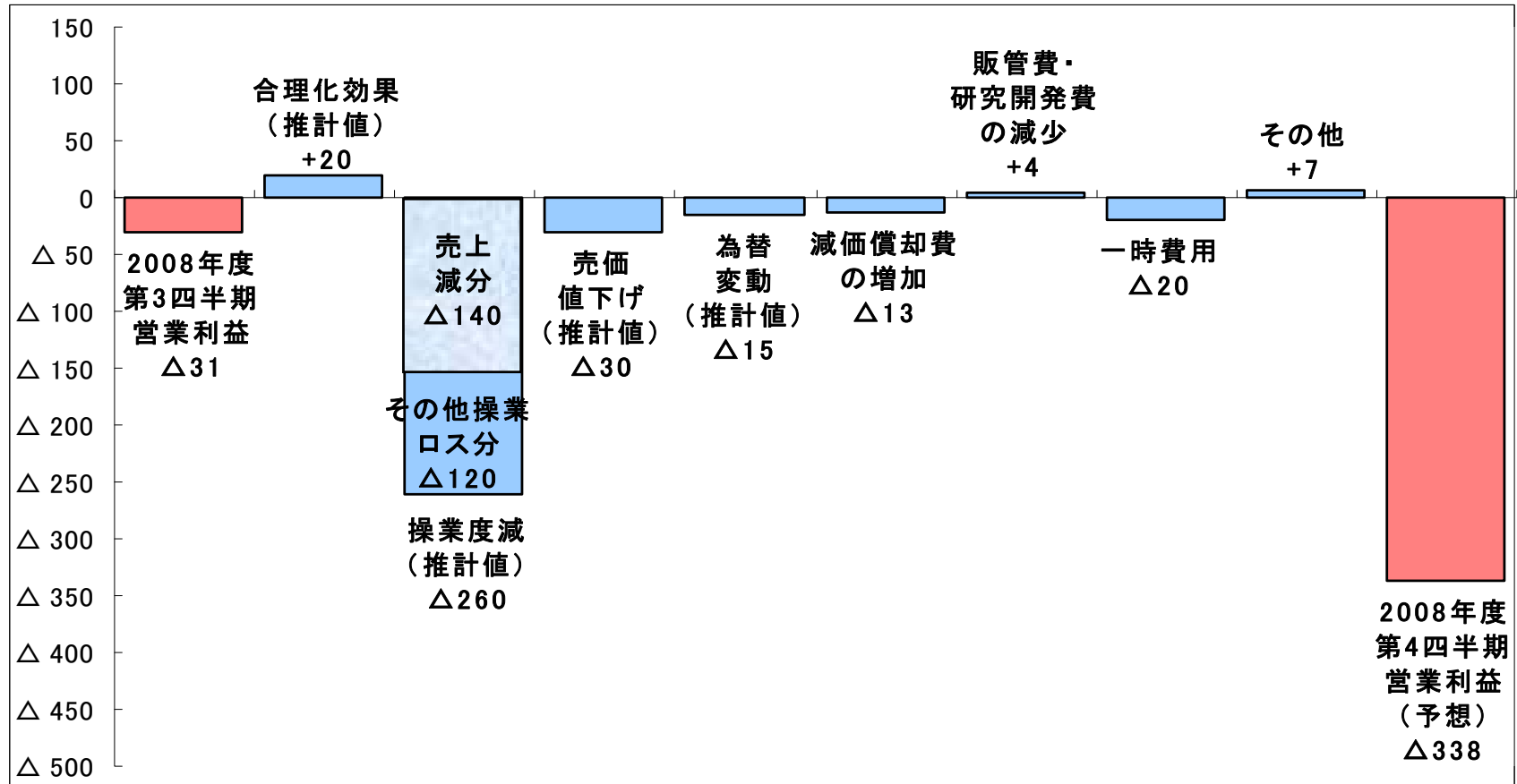
	前回予想 (08/10)		今回予想				
	2008年度 通期予想		上期 実績	第3四半期 実績	第4四半期 予想	2008年度 通期予想	
	(億円)	(%)				(億円)	(%)
売上高	6,050	+1.3	3,040	1,268	932	5,240	▲17.0
営業利益(▲損失)	400	▲39.5	269	▲31	▲338	▲100	-
税引前利益	460	▲38.4	287	28	▲315	0	-
純利益(▲損失)	300	▲39.9	190	▲13	▲177	0	-

※(%)は前期比伸び率

	上期実績	第3四半期実績	第4四半期予想
	(億円)	(億円)	(億円)
たな卸資産(期末残高)	1,262	1,179	約 1,000

# 2008年度第4四半期業績予想 利益変動要因

(億円)



# 製品別売上予想

	2008年度通期予想(前期比)		2008年度
	今回予想	前回予想 (08/10)	第4四半期予想 (第3四半期比)
コンデンサ	▲30%程度	▲13%程度	▲30%程度
圧電製品	▲20%程度	▲3%程度	▲20%程度
高周波デバイス	+5%程度	+13%程度	▲20%程度
モジュール (MPS除く)	▲15%程度 (▲25%程度)	▲5%程度 (▲12%程度)	▲20%程度 (▲20%程度)
その他	▲15%程度	+2%程度	▲30%程度

# 用途別売上予想

	2008年度通期予想(前期比)		2008年度 第4四半期予想 (第3四半期比)
	今回予想	前回予想 (08/10)	
AV	▲20%程度	▲15%程度	▲30%程度
通信 計 (うち携帯電話)	▲10%程度 (▲8%程度)	+2%程度 (+4%程度)	▲20%程度 (▲20%程度)
PC及び関連機器	▲25%程度	▲10%程度	▲30%程度
カーエレ	▲20%程度	▲3%程度	▲30%程度
家電・その他	▲30%程度	▲2%程度	▲20%程度

# 業績予想の前提

	2008年度 上期実績	2008年度 下期予想	2008年度 通期予想
減価償却費	385億円	415億円	800億円
研究開発費	236億円	234億円	470億円
設備投資額	430億円	270億円	700億円
為替レート(US\$)	106.11円/US\$	90.00円/US\$	

**2008年度(09年3月期)の配当(予定)**  
**1株当たり年間100円(うち中間配当50円)**

**2007年度の配当実績**  
**1株当たり年間100円(うち中間配当50円)**

※当配当は現時点での事業環境予測及び業績予想に基づくものであります。

# 収益改善策

## 営業利益改善のための施策

単位：億円

	年間効果額
派遣・請負人員の削減	250
固定費の削減	270
合計	520

## ○派遣・請負人員の削減（08年9月末実績→09年3月末計画）

- ・国内 4,000名
- ・海外 500名

## ○固定費の削減

- ・人件費・経費の削減
- ・減価償却費の低減
- ・生産関連費用の削減
- ・国内外生産拠点の生産品種の集約 など

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。